

반도체 Ptfе 웨이퍼 캐리어 8인치 습식 세정 Hf 내성 에칭 카세트

품목 번호: PL-CP82



소개

고순도 습식 세정 및 HF 에칭 공정을 위해 설계된 고품질 PTFE 8인치 웨이퍼 캐리어로 반도체 공정을 최적화하세요. 당사의 산업용 불소중합체 카세트는 민감한 클린룸 생산 환경에서 최대의 내화학성, 우수한 내구성 및 정밀한 핸들링을 보장합니다.

자세히 알아보기

적용 분야	설명	주요 이점
실리콘 웨이퍼 에칭	HF 기반 화학물질을 사용한 희생층 제거 공정 중 웨이퍼 핸들링	산 공격에 대한 완전한 내성으로 캐리어 수명을 보장합니다.
RCA 세정 공정	유기 및 이온성 오염물 제거의 여러 단계에서 웨이퍼 지지	재료 순도로 세정된 표면의 재오염을 방지합니다.
CMP 후 세정	평탄화 후 세정 브러시와 화학 욕조를 통해 웨이퍼 이송	낮은 입자 방출로 매우 낮은 결합 수를 유지합니다.
포토리지스트 스트리핑	리소그래피 후 감광성 코팅을 제거하기 위해 강력한 용매 사용	화학적 불활성으로 용매 욕조에서 재료 열화를 방지합니다.
태양전지 제조	고산 환경에서 PV 전지의 대형 기판 공정 지원	고용량 생산에서의 내구성으로 교체 비용을 절감합니다.
MEMS 제조	복잡한 습식 릴리스 공정 중 섬세한 마이크로전자기계 시스템 관리	정밀한 슬롯 정렬로 구조물의 기계적 손상을 방지합니다.
분석 샘플링	고순도 미량 금속 분석용 기판 홀더로 캐리어 사용	초저 백그라운드 레벨로 정확한 실험실 결과를 보장합니다.

특정 카테고리	PL-CP82의 기술 세부 사항
제품 식별	PL-CP82 시리즈 맞춤형 웨이퍼 캐리어
주요 재료	고순도 버진 PTFE (폴리테트라플루오로에틸렌)
웨이퍼 크기 호환성	표준 8인치(200mm) / 완전 맞춤형 직경
구성 유형	단일 웨이퍼(개별형) 또는 다중 슬롯 옵션 제공
제조 방식	100% 정밀 CNC 가공 (성형 잔류물 없음)
온도 범위	-200°C ~ +260°C (-328°F ~ +500°F)
화학 적합성	범용 (HF, HCl, H2SO4, KOH, 아세트 등)
표면 거칠기	특정 클린룸 요구 사항에 따라 맞춤 설정 가능
슬롯 피치 / 깊이	고객별 공정 파라미터에 맞춰 제작
핸들 / 인터페이스	맞춤형 로봇 픽업 지점 또는 수동 그립 옵션
치수 정확도	산업 표준에 따른 고정밀 공차 제어